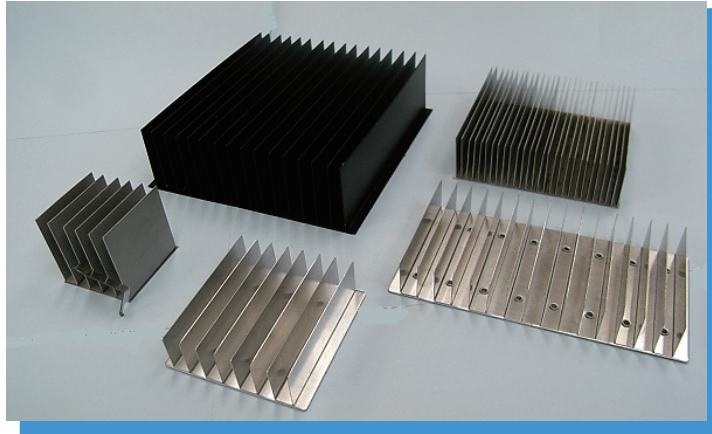


超軽量ヒートシンク(ハリーシンク)



実用新案登録第3130026号

本ヒートシンクの基本的な使い方

冷却したい部品や部分に本ヒートシンクを ねじやスプリング等の固定部品を利用して押し付けて使う方法のほか、両面粘着熱伝導性シートあるいは熱伝導性接着剤で貼り付けることができます。

本ヒートシンクの特徴

- ①超軽量です。(従来相当品の1/3~1/6)
フィン、ベースの板厚例
フィン : 0.2mmt~0.3mmt、 ベース : 0.3mmt~0.5mmt
- ②フィンとベースの接合方法は用途に応じて選定することができます。
- ③軽量なので取り付け部品に負担がかかりません。
- ④自然空冷用と強制空冷用をご用意できます。
- ⑤放熱性は従来の同一表面積品と同等です。
- ⑥用途は自由です。
(例) BGA、一般半導体素子、FPD、ペルチェ素子、LED、筐体
- ⑦部品への取り付け面に高粘着性の両面粘着伝導性シートを装着した製品もご用意できます。放熱したい部品への取り付けが簡単です。いざというときは取り外しもできます。
- ⑧ベースはアルミの薄板なのでご要望によりプレス成形加工が可能です。
- ⑨低コスト化を可能にします。

●熱特性例(ベース全面均熱発熱でヒートシンクのための熱抵抗を示します)

名 称	重量(g)	熱抵抗(°C/W)	備 考
HS-50-50-15-6	9	7.0	自然空冷(フィン方向は地面に垂直。表面処理 なし)
HS-70-70-20-6	23	3.3	〃
HS-100-100-30-6	57	1.4	〃
HS-50-50-15-2	17	1.1	強制空冷(風速2m/s)
HS-70-70-20-2.5	40	0.60	〃
HS-100-100-30-3	95	0.32	〃

(注)名称の意味:HS(ハリーシンク)ー幅ー長さー高さーフィンピッチ